

Micro SLP 電線対基板コネクタ 2pos, 0.8mm Pitch
(Micro SLP Wire to Board Connector 2pos, 0.8mm Pitch)

1. 適用範囲

本規格は Micro SLP Wire to Board Connector 2pos, 0.8mm Pitch の取付に関する必要条件について規定する。

1. Scope :

This specification covers the requirements for application of following Micro SLP Wire to Board Connector 2pos 0.8mm pitch.

2. 適用コネクタ

2. Applicable Connectors

表 1 : Table 1

BOARD SIDE		CABLE SIDE	
Part Number	Product Description	Part Number	Product Description
1981813-1	Board Connector	X-1981812-X	Wire Connector

3. 各部の名称

(FIG-1参照)

3. Nomenclature of Product and Terminated

Name. (See FIG-1)

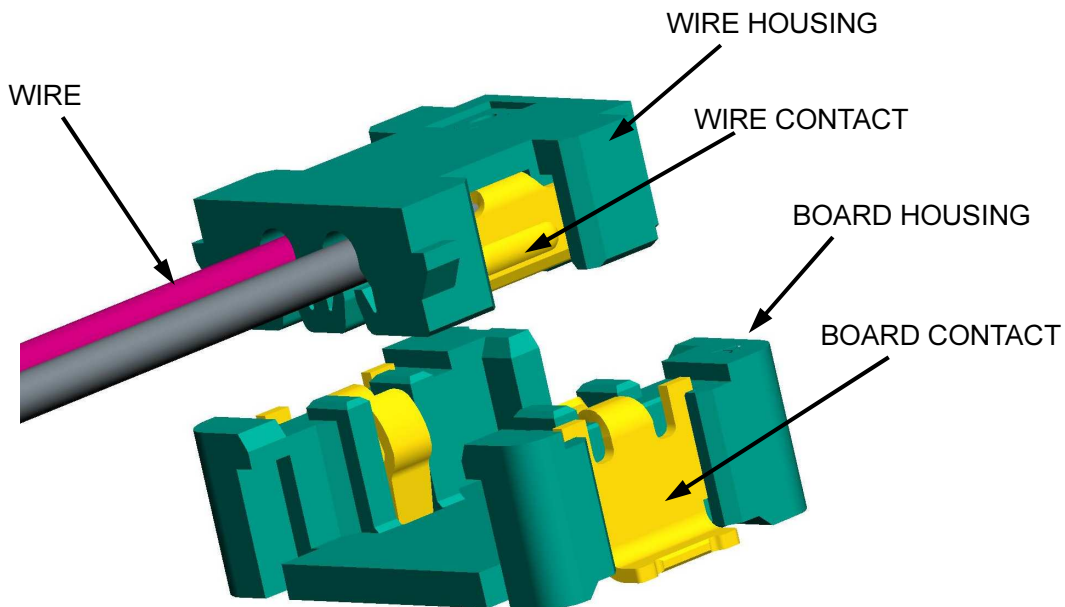


FIG-1

4. 必要条件

4. Requirements

4.1 保管

4.1 Storage

本コネクタを保管する際は、ゴミ、ホコリ等が入らないように梱包状態のままの状態、有毒ガスがなく、且つ常温常湿の環境下での保管を推奨します。
(常温常湿：5～35℃、45～75%RH)

We recommend that the connector remain in the container to prevent contamination or dust, and that it stored, keeping at normal temperatures, normal humidity and no poisonous gas.
(Normal temperatures and humidity : 5～35℃、45～75%RH)

4.2 ワイヤ側コネクタ

4.2 Wire side connector

ワイヤ側コネクタのワイヤ圧接作業はタイコインターナショナルにて行なわれます。
以下の項目について指定下さい。

Wire side connector have to be connected the special wire by Tyco Electronics.
Please specify the below item.

- ・ ワイヤの長さ
- ・ 先端ストリップ長さ
- ・ 被覆の色
(FIG-2 参照)

- Wire total length
- Wire strip length
- Insulation color
(Refer to FIG-2)

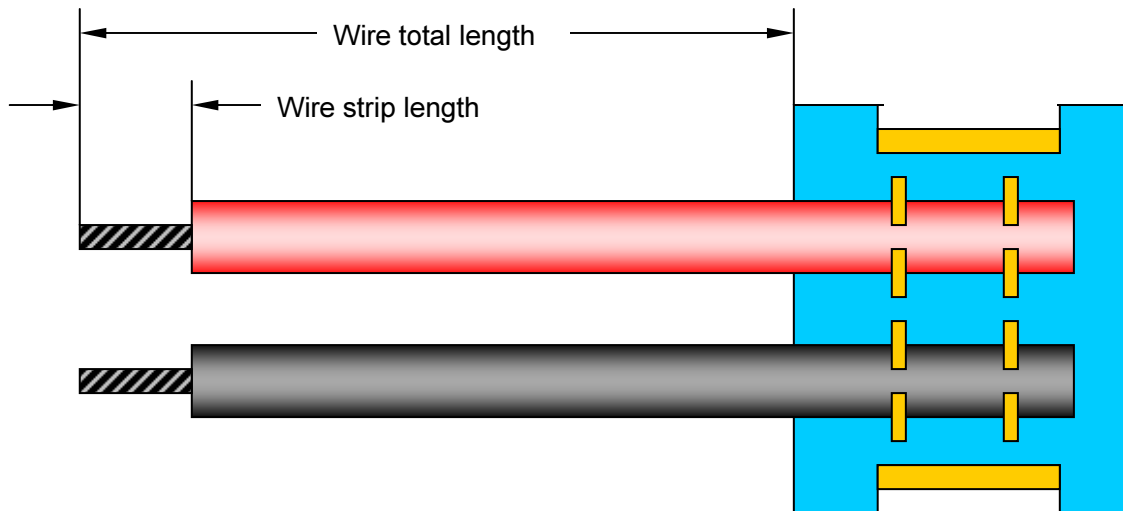


FIG-2

4.3 基板側コネクタ

4.3 Board side connector

4.3.1 基板レイアウト

4.3.1 PC Board Layout

下図又は C-DWG を御参照下さい。

Please refer to below or customer drawing.

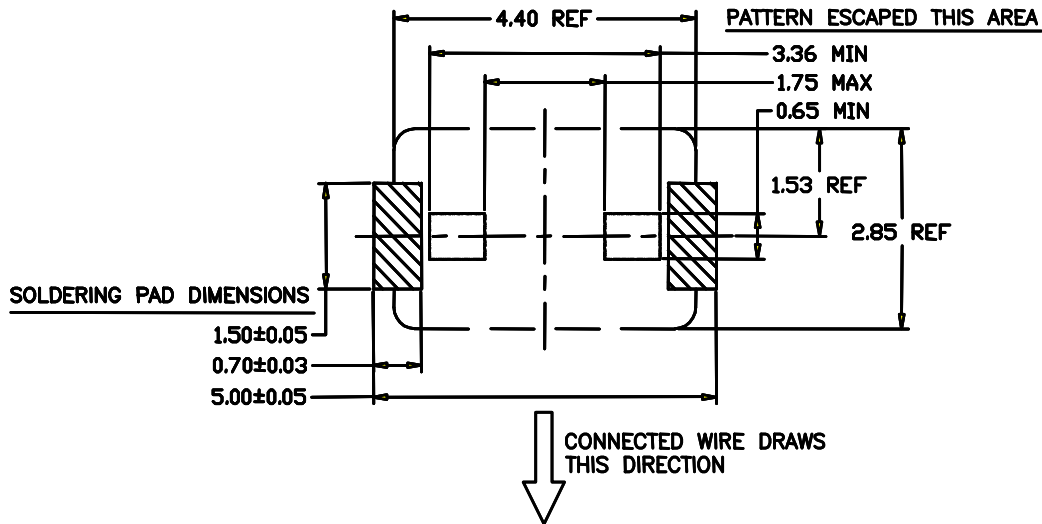


FIG-2 REFERENCE PC BOARD LAYOUT TOP VIEW

4.3.2 自動実装

4.3.2 Pick and Place

下図を御参照下さい。

Please refer to below drawing.

- ・ 吸着エリアはΦ 1.5mmです。
- ・ 吸着ノズルがコンタクト接点部に触れないようにご注意ください。接点部のキズや変形の恐れがあります。(FIG-3 参照)

- Pick and Place area is 1.5mm Diameter.
- The nozzle of pick and place Machine must not touch the contact. The contact is deformed. (Refer to FIG-3)

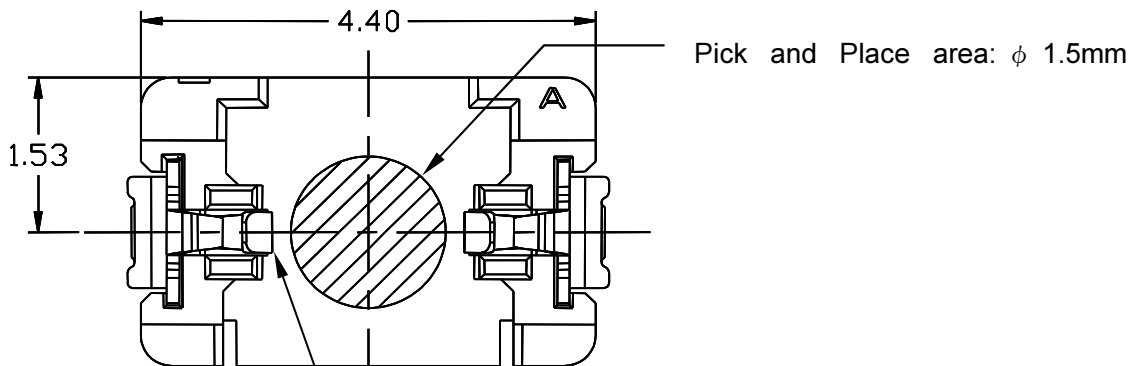


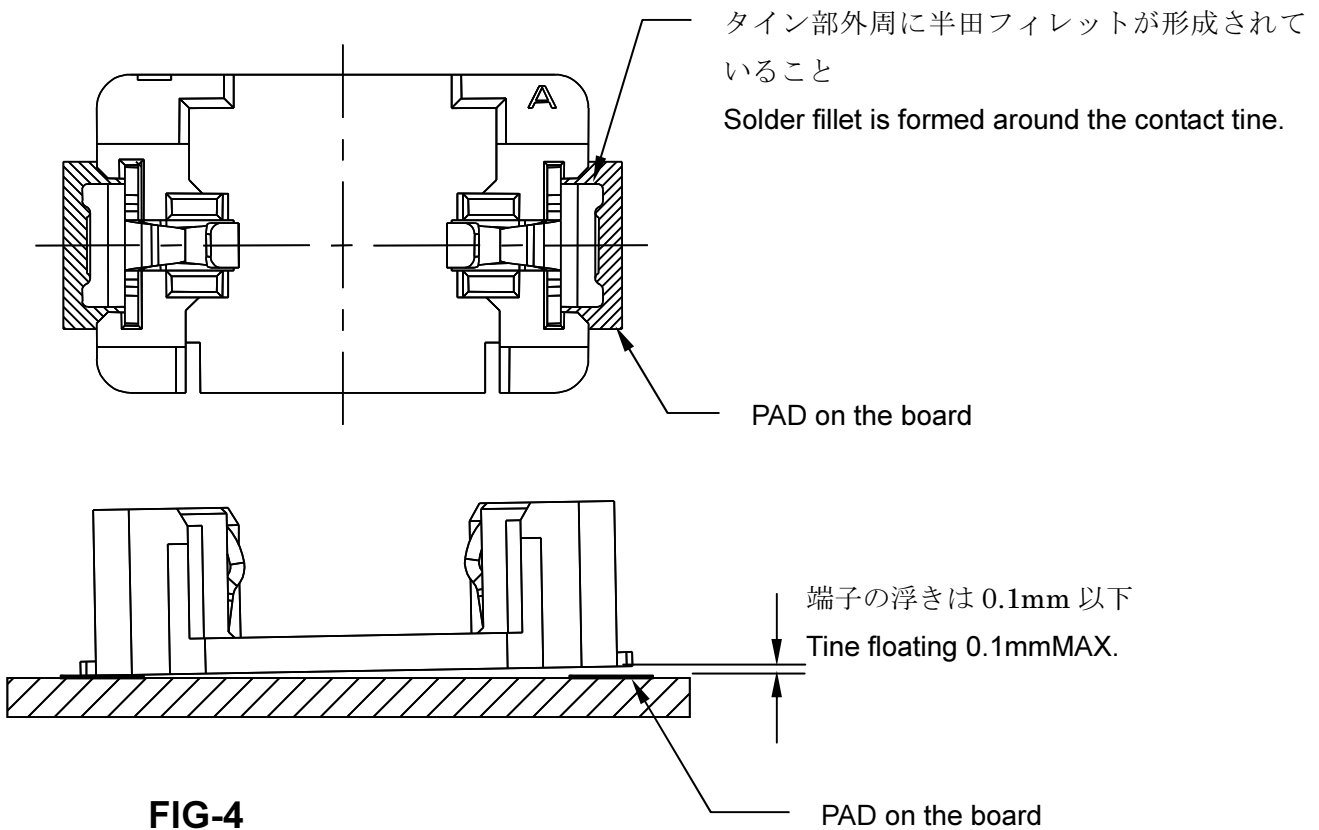
FIG-3 Must not touch these contact point.

4.4 基板への取り付け作業

コネクタの半田タイン部及び接触バネ部分を変形させないように保持して、基板面と水平に取り付ける様に自動実装機の調整をお願い致します。
 又、半田付けはリフローを原則としておりますが、半田付け部の手直し等により半田コテをご使用になる場合には、タイン部にコテ先が触れないように注意下さい。(手半田の条件：108-78466 を御参照下さい)
 (FIG-4 参照)

4.4 PC Board Layout

Adjust mounting device of automatic placement machine accordingly, so as to get the connectors held horizontally with the surface of P.C.B. care should be taken such that the soldering tines and spring contacts are not deformed during this operation.
 This connector is designed for flow soldering. However, when the use of soldering iron is required for rework, care must be taken not to let the tip end of the iron touch on the tines of the connector as this will deform the tines. The solder iron tip should touch on the P.C.B. solder pads only.
 (Please refer to 108-78466 about the heat condition)
 (Refer to FIG-4)



4.5 嵌合離脱方法

- 嵌合はワイヤ側コネクタをなるべく水平にして嵌合させること。片側だけを押し込んで斜めに嵌合させると基板側コネクタのコンタクトを破損させる恐れがあります。(FIG-5,FIG-6 参照)
- 嵌合はワイヤ側コネクタがロックされるまでしっかり押し込み、後のコネクタは上面がフラットであること。(FIG-7,FIG-8 参照)
- 外すときはワイヤ側コネクタの反対側を引っ掛けて外すことを推奨しますが、ワイヤを引っ張る場合は極端に強く引き上げないこと。(FIG-9,FIG-10 参照)

4.5 Mating and Un-mating

- Mating : Wire side connector has to be keep horizontal condition when the mating. (Refer to FIG-5, FIG-6)
- Mating condition : Wire side connector has to be locked. (Refer to FIG-7, FIG-8)
- Un-mating : About un-mating, recommend direction is the counter side face of wire.
- If un-mating by the wire, do not be strong force. (Refer to FIG-9, FIG-10)

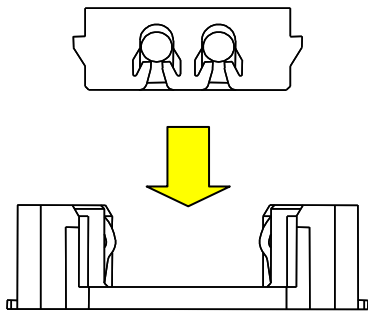


FIG-5

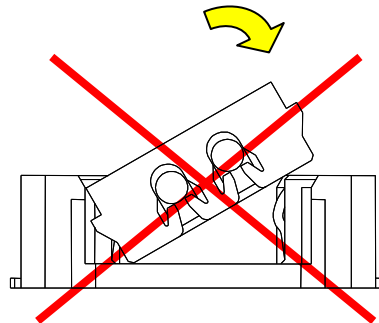


FIG-6

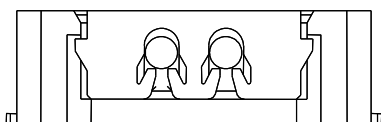


FIG-7

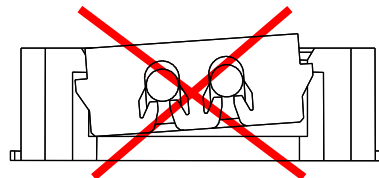


FIG-8

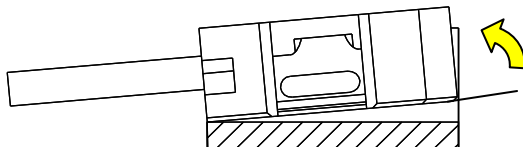


FIG-9

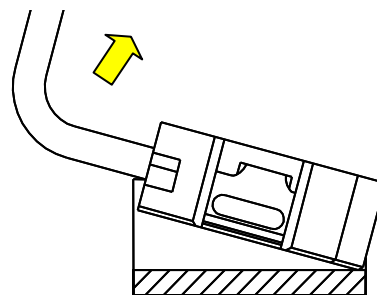


FIG-10